

御 得 意 様 各 位

JPCA Show 2023 出展のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて弊社はこのたび「JPCA Show 2023」において高機能ビアフィル用添加剤や高精度のシード層エッチング液など
 微細回路形成に対応したプリント配線板用の各種処理薬品や、センサーやパワーモジュール向けの半導体プロセス用
 薬品を出展いたします。是非ご来場賜り、弊社出展品をご高覧頂きたくご案内申し上げます。
 また、最終日の6月2日はNPIプレゼンを実施いたします。聴講は無料のためお気軽にお越しください。

敬具

記

日 時：2023年5月31日(水)~6月2日(金)

開場時間：10：00~17：00

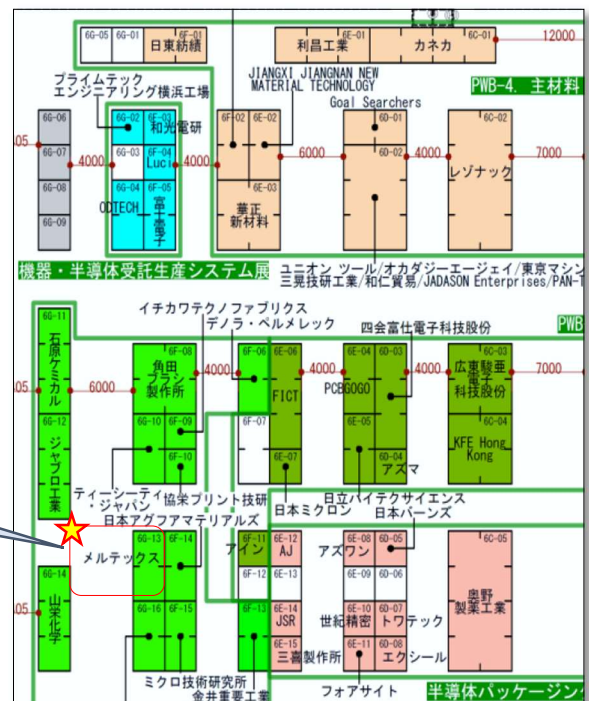
【展示品】

- 液流依存性が少なく膜厚分布に優れた高電流密度対応ビアフィル添加剤
- 低温でも性能を発揮する微細配線対応酸性脱脂剤
- 平滑な表面が得られ、浴安定性に優れた無電解銅シード層エッチング液
- 耐塩素性能を有するMSAPに最適化された銅箔シード層エッチング液
- Fan-Out Panel Level Packaging 対応チタンシード層エッチング液
- 厚膜及び微細回路対応ドライフィルム剥離剤
- 信頼性の高い微細配線形成に貢献するドライフィルム裾引き残渣除去剤
- 他金属を侵さず銅スパッタ表面の酸化膜を効果的に除去する半導体用前処理剤

【弊社ブース】

東京ビッグサイト 東展示棟 第6ホール・6G-13

東6ホール
小間番号[6G-13]



【出展者（NPI）プレゼンテーション】 *聴講無料

【講演題目】：微細回路形成用硫酸銅めっきプロセスのご紹介

【講演内容】：半導体 IC チップの小型化・高性能化による、パッケージ基板の配線微細化に伴い、高性能なパターンビアフィル技術が要求されています。本講演では小径ビアホールへの浸透性に優れ、ドライフィルムレジストへのダメージを低減させた酸性脱脂剤『メルプレート CL-2000』および優れた膜厚均一性を有するビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤『ルーセントカパー IVF』についてご紹介いたします。

【講演者】：技術研究所 応用開発 1 課 近藤 厚

【日時】：2023年6月2日（金） 11:35~11:55

【場所】：<展示ホールセミナー会場 M> NPI セミナー会場②

* 直接、会場にお越しください

